

【大阪市内】 3D CAD機械設計／半導体運搬装置の設計エンジニア (Junior Engineer／Osaka)

『油圧シリンダ国内トップシェア』90年以上の実績を誇る安定成長の外資系メーカー

募集職種

採用企業名

株式会社 Parker TAIYO

求人ID

1572622

部署名

--

業種

機械

会社の種類

大手企業 (300名を超える従業員数) - 外資系企業

雇用形態

正社員

勤務地

大阪府, 大阪市東淀川区

最寄駅

京都本線、相川駅

給与

450万円 ~ 750万円

ボーナス

給与：ボーナス込み

歩合給

給与：歩合給込み

勤務時間

8:30~17:05

休日・休暇

土日祝日、GW・夏季・年末年始休暇（会社カレンダーあり・年1日程度土曜出勤日あり）

更新日

2026年02月17日 00:00

応募必要条件

職務経験

1年以上

キャリアレベル

中途経験者レベル

英語レベル

無し

日本語レベル

ビジネス会話レベル

最終学歴

専門学校卒

現在のビザ

日本での就労許可が必要です

募集要項

半導体ウェハー搬送装置の3D CADを使用した設計業務を担当いただきます。

◎主な業務：仕様設計、詳細設計、設計変更提案、図面の確認、関係部門や顧客との折衝・調整など

◎使用CAD：iCAD

年に数回客先への出張があります。

スキル・資格

- ・3D CADでの機械設計経験（使用CAD不問）
 - ・日本語ネイティブルベル
-

会社説明